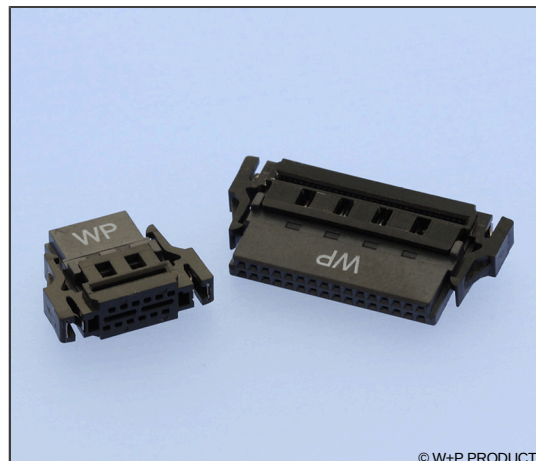


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt	AWG 30
<i>Applicable wire Gauge</i>	<i>AWG 30</i>
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>< 30 mΩ</i>
Spannungsfestigkeit	150 V
<i>Test Voltage</i>	<i>150 V</i>
Nennstrom	0,5 A
<i>Current Rating</i>	<i>0.5 A</i>
Temperaturbereich	-20 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-20 °C ... +105 °C</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:

*Compatible Connectors:***9019 9020**

Passende Flachbandkabel:

*Compatible Flat Cables:***3568**

9017 9018 9019 9020

Derating / Übersicht über die erreichbaren Bauhöhen

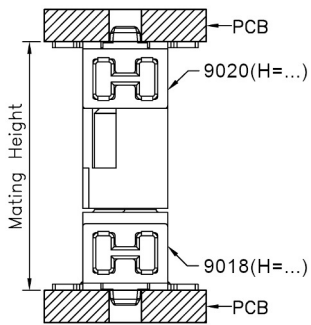
Derating / Chart of Attainable Mating Heights

Derating

°C	12p	50p	80p
20	2.9 A	2.1 A	1.6 A
70	2.2 A	1.6 A	1.1 A
100	1.4 A	1.0 A	0.6 A

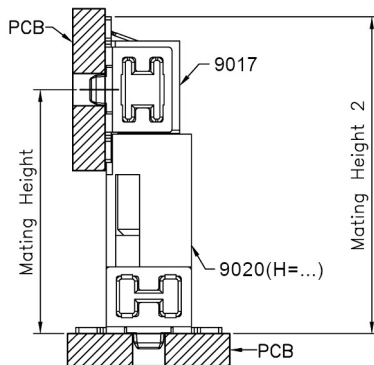
Derating-Werte in Ampère in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur und Polzahl.

Derating values in Amp with respect to environmental temperature and selected numbers of contacts.



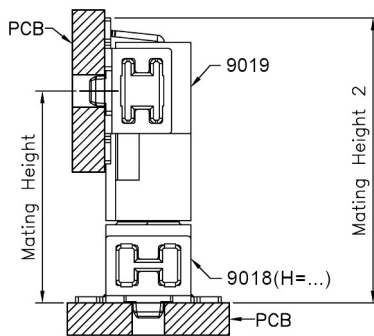
9018 + 9020

Mating Height		9020		
		H=6.75mm	H=8.25mm	H=9.85mm
9018	H=6.25mm	8.0 - 9.5	9.5 - 11.0	11. - 12.6
	H=9.05mm	10.8 - 12.3	12.3 - 13.8	13.9 - 15.4
	H=13.65mm	15.4 - 16.9	16.9 - 18.4	18.5 - 20.0



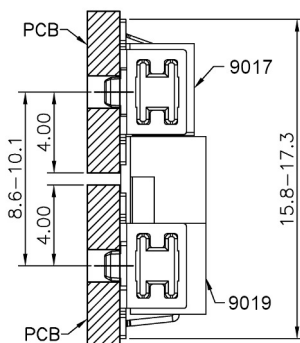
9017 + 9020

Mating Heights		9020		
		H=6.75mm	H=8.25mm	H=9.85mm
9017	8.95 - 10.45	10.45 - 11.95	12.05 - 13.55	15.65 - 17.15
	12.55 - 14.05	14.05 - 15.55	15.65 - 17.15	



9018 + 9019

Mating Heights		9018		
		H=6.25mm	H=9.05mm	H=13.65mm
9019	7.65 - 9.15	10.45 - 11.95	15.05 - 16.55	18.65 - 20.15
	11.25 - 12.75	14.05 - 15.55		



9017 + 9019

Für 9017 und 9019 bestehen keine Bauhöhenoptionen. Der gekennzeichnete Abstand beträgt 15.80 - 17.30mm.

There are no profile options for 9017 and 9019. The marked dimension is 15.80 - 17.30mm.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

